

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
27. April 2023 (27.04.2023)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2023/066463 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/78 (2006.01) *H01L 23/544* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2021/078918

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. Oktober 2021 (19.10.2021)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder: **EV GROUP E. THALLNER GMBH**
[AT/AT]; DI Erich Thallner Str. 1, 4782 St. Florian am Inn
(AT).

(72) Erfinder: **BURGGRAF, Jürgen**; DI Erich Thallner Straße
1, 4782 St. Florian am Inn (AT). **WIMPLINGER, Markus**;
DI Erich Thallner Straße 1, 4782 St. Florian am Inn
(AT). **UHRMANN, Thomas**; DI Erich Thallner Straße 1,
4782 St. Florian am Inn (AT). **LINDNER, Friedrich, Paul**;
DI Erich Thallner Straße 1, 4782 St. Florian am Inn (AT).

(74) Anwalt: **SCHNEIDER, Sascha**; Turmstraße 22, 40878
Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,

DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

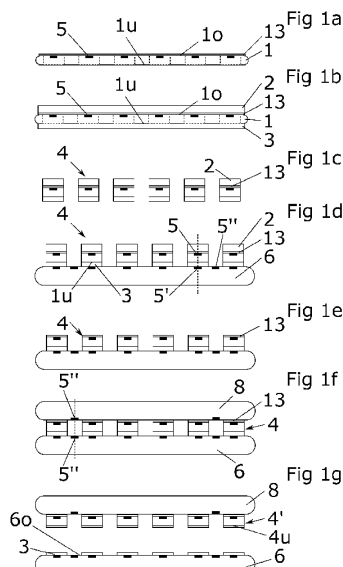
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR THE PRODUCTION AND PROVISION OF ELECTRONIC COMPONENTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN UND ZUM BEREITSTELLEN VON
ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for production and
provision of electronic components.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Erzeugen und Bereitstellen von elektronischen Bauteilen.



WO 2023/066463 A1